

## Programm zur Förderung der Fertigung von elektronischen Komponenten und Halbleitern (SPECS)

### 1. Hintergrund

Die Regierung misst der Herstellung von Elektronik-Hardware hohe Priorität bei, da sie eine der wichtigen Säulen sowohl des „Make in India“- als auch des „Digital India“ Programms der indischen Regierung ist. Die Elektronikfertigungsindustrie in Indien sieht sich derzeit mit Behinderungen in der Größenordnung von 8 - 10% im Vergleich zu konkurrierenden Wirtschaften in verschiedenen Segmenten der Elektronikfertigung sowie in verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette konfrontiert.

1.2 Die Herstellung von Haushaltselektronik hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen und bewegt sich ständig von der Fertigung auf der Ebene der teilzerlegten (Semi-Knocked Down - SKD) bis zur Fertigung auf der Ebene der vollständig zerlegten (Completely Knocked Down - CKD). Die inländische Wertschöpfung ist jedoch nach wie vor nur in einer Größenordnung von 10 - 30% gering. Dies ist auf das fehlende Geschäftsfeld der Herstellung elektronischer Komponenten, das fast fehlende Geschäftsfeld der Halbleiterherstellung und das mangelhafte Geschäftsfeld der Display-Herstellung im Land zurückzuführen. Ein erhebliches Wachstum der inländischen Elektronikfertigung ist auf die Montage von Fertigprodukten aus importierten elektronischen Komponenten/Unterbaugruppen/Teilen zurückzuführen, die hauptsächlich die inländische Nachfrage befriedigen.

1. Die 3D-Entwicklung der Lieferkette ist für die Herstellung von elektronischen Produkten mit höherer Wertschöpfung im Inland unerlässlich. Die am 25.02.2019 bekannt gegebene Vision der Nationalen Politik für Elektronik 2019 (NPE 2019) ist es, Indien als globalen Knotenpunkt für die Entwicklung und Herstellung von Elektroniksystemen (ESDM) zu positionieren, indem die Fähigkeiten des Landes zur Entwicklung von Kernkomponenten, einschließlich Chipsätzen, gefördert und vorangetrieben werden und ein förderliches Umfeld für die Industrie geschaffen wird, um im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein.

1.4 Die Herstellung von elektronischen Komponenten und Halbleitern ist anlageintensiv und muss sich mit der sich ständig ändernden Technologie befassen. Komponenten sind das Kernstück elektronischer Produkte und machen einen wesentlichen Teil des Gesamtwertes der Stückliste (BOM) aus. Ein dynamisches Ökosystem für die Herstellung elektronischer Komponenten ist für das langfristige und nachhaltige Wachstum der Elektronikfertigung in Indien insgesamt und für das Ziel einer positiven Netto-Zahlungsbilanz (BoP) von entscheidender Bedeutung.

1.5 Zu den Haupthindernissen bei der Anwerbung von Investitionen für die Herstellung von elektronischen Komponenten/Halbleitern gehören die Einfuhr zum Basiszollsatz "Null" (BCD), da die meisten elektronischen Komponenten/Halbleiter unter das Informationstechnologie-Abkommen (ITA-1) der WTO fallen; hohe Kapitalkosten für den Aufbau von Kapazitäten im globalen Maßstab, um wettbewerbsfähig zu sein; unzureichende Infrastruktur; fehlende Verfügbarkeit von angemessener, zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Energie- und Wasserversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen; fehlende Lieferkette; hohe Logistikkosten; fehlende Technologie usw.

1.6 Das modifizierte Sonderanreizpaketprogramm (M-SIPS) wurde als ein Programm konzipiert, das finanzielle Anreize bieten soll, um die Behinderung und die hohen Vorlaufkosten auszugleichen und dadurch Investitionen in den Elektronikherstellungssektor anzuziehen. Dieses Programm war bis zum 31.12.2018 für neue Projekte sowie für Erweiterungsprojekte offen, um Anträge zu erhalten. Das Programm sah Zuschüsse für Investitionen in Investitionsausgaben für die Einrichtung von Elektronikfertigungsanlagen vor (20% für Einheiten, die in SonderWirtschaftszonen (SWZ)-Einheiten eingerichtet wurden, und 25% für Einheiten außerhalb der SWZ). M-SIPS hat eine wichtige Rolle bei der Förderung von Investitionen in die Elektronikfertigung in Indien gespielt.

## **2. Schema zur Förderung der Herstellung von elektronischen Komponenten und Halbleitern (SPECS)**

2.1 Es wird vorgeschlagen, einen finanziellen Anreiz in Höhe von 25% der Investitionsausgaben für die Herstellung von Gütern gemäß der beigefügten Liste zu bieten, die die Lieferkette eines elektronischen Produkts im Rahmen des Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS) bilden.

## **3. Ziel**

3.1 Die Regelung wird dazu beitragen, die Behinderung für die inländische Fertigung von Komponenten und Halbleitern auszugleichen, um das Ökosystem der Elektronikfertigung im Land zu stärken.

#### **4. Wählbarkeit**

4.1 Die SPECS gelten für Investitionen in neue Einheiten sowie für die Kapazitätserweiterung/Modernisierung und Diversifizierung bestehender Einheiten.

#### **5. Schwellenwert**

5.1 Die Mindestinvestitionsschwelle, die im Rahmen der Regelung förderfähig ist, ist im Anhang aufgeführt.

5.2 Die Schwellenwerte sind für neue Einheiten oder Kapazitätserweiterung/Modernisierung und Diversifizierung bestehender Einheiten gleich.

5.3 Zyklische Überprüfungen werden in Bezug auf eventuelle Änderungen der Liste der Waren/Schwellenwerte, für die Anreize vorgesehen sind, vorgenommen.

#### **6. Die Dauer des Programms**

6.1 Die SPECS werden zunächst für 3 Jahre ab dem Datum ihrer Bekanntgabe für Anträge offenstehen. Die im Rahmen des Programms eingegangenen Anträge werden laufend geprüft, und die Umsetzung wird entsprechend den im Rahmen des Programms erteilten Genehmigungen fortgesetzt.

#### **7. Die Anreize im Rahmen des Programms**

7.1 Den Einheiten, die Investitionen für die Güter gemäß der beigefügten Liste tätigen, wird ein Anreiz von 25 % auf die Kapitalausgaben gewährt. Der Anreiz wird auf der Grundlage einer Rückerstattung gewährt.

7.2 Bei den Investitionsausgaben handelt es sich um die Summe der Ausgaben für Anlagen, Maschinen, Ausrüstung, zugehörige Versorgungseinrichtungen und Technologie, einschließlich Forschung und Entwicklung (F&E). Einzelheiten zu diesen förderfähigen Investitionsausgaben werden in den Richtlinien enthalten sein. Der Gesamtwert der überholten Anlagen, Maschinen und Ausrüstungen (einschließlich für zugehörige Versorgungseinrichtungen und F&E), unabhängig davon, ob sie importiert oder im Inland beschafft wurden, wird bei der Berechnung des diesbezüglichen Anreizes berücksichtigt, wobei nicht mehr als 20% der gesamten förderfähigen Anlagen, Maschinen und Ausrüstungen (einschließlich für zugehörige Versorgungseinrichtungen und F&E) berücksichtigt werden.

7.3 Die von der Staatsregierung oder einer ihrer Behörden oder lokalen Einrichtungen gegebenenfalls angebotenen Anreize gehen über den im Rahmen des vorgeschlagenen Programms förderfähigen Anreiz hinaus.

7.4 Die Antragsteller sind auch für die Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen anderer Programme der indischen Regierung berechtigt. Investitionen, die von den Antragstellern im Rahmen des M-SIPS-Programms zugesagt wurden und für die Anreize beantragt wurden, gelten jedoch nicht als förderfähige Investitionen im Rahmen des SPECS-Programms.

## **8. Genehmigungs- und Auszahlungsprozess**

8.1 Anträge im Rahmen der Regelung können von jeder in Indien registrierten Organisation gestellt werden.

8.2 Jeder einzelne Antrag wird als Neuinvestition behandelt und als eigenständiger Antrag behandelt. Der Antrag wird nur für einphasige Projekte gestellt, und phasenweise Anträge werden im Rahmen des Programms nicht berücksichtigt. Es gibt keine Beschränkung für jeden Antragsteller, mehrere Anträge und/oder für mehrere Standorte zu stellen.

8.3 Ein in jeder Hinsicht ausgefüllter und vor dem Fälligkeitsdatum des Programms eingereichter Erstantrag wird laufend geprüft und zur Genehmigung in Betracht gezogen.

8.4 Der Anreiz im Rahmen des Programms gilt ab dem Datum der Bestätigung des Antrags. Die Bestätigung wird nach einer ersten Prüfung des Antrags ausgestellt. Die Bestätigung des Antrags ist nicht als Genehmigung im Rahmen von SPECS auszulegen.

8.5 Der Anreiz steht für Investitionen zur Verfügung, die innerhalb von 5 Jahren ab dem Datum der Bestätigung des Antrags getätigt werden.

8.6 Der Anreiz für die erstattungsfähigen Investitionsausgaben wird nach der Genehmigung des Antrags freigegeben, sofern die Investitionsausgaben den Schwellenwert überschreiten und die kommerzielle Produktion aufgenommen wird. Die nachfolgenden Anträge auf den Anreiz können auf halbjährlicher Basis eingereicht werden.

8.7 Die Einheit, die den Anreiz im Rahmen von SPECS erhält, muss mindestens 3 (drei) Jahre ab dem Datum des Produktionsbeginns oder 1 (ein) Jahr ab dem Datum des Erhalts des letzten Anreizes in der kommerziellen Produktion bleiben, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.

## **9. Führungsmechanismus**

9.1 Das Programm wird über eine Knotenpunktagentur umgesetzt. Die Knotenpunkt-Agentur würde die Bewertung des Antrags vornehmen.

9.2 Solche Knotenpunktagentur wird als Projektmanagementagentur (PMA) arbeiten und für die Bereitstellung von Sekretariats-, Verwaltungs- und Umsetzungsunterstützung sowie für die Durchführung anderer Aufgaben, die von Zeit zu Zeit von MeitY zugewiesen werden, verantwortlich sein. Die Arbeitsweise und die Zuständigkeiten der PMA werden in den von MeitY gesondert herauszugebenden Richtlinien für das Schema ausgearbeitet.

9.3 Für die Durchführung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umsetzung von SPECS würde die PMA die folgenden Aufgaben übernehmen u.a:

9.3.1 Empfang des Antrags, Ausstellung von Bestätigungen, Durchführung von Bewertungen und Überprüfung der Förderfähigkeit der Antragsteller im Rahmen des Programms.

9.3.2 Prüfung der Auszahlungsansprüche und Auszahlung des Anreizes an die genehmigten Antragsteller.

9.3.3 Vorlage von periodischen Berichten an MeitY über den Fortschritt und die Leistung des Programms

9.4 Die PMA wird die bewerteten und als zulässig befundenen Anträge dem Exekutivausschuss (EC) vorlegen, der vom Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) gebildet wird. Den Vorsitz des Exekutivausschusses wird ein Beamter führen, der nicht unter dem Rang eines gemeinsamen Sekretärs in MeitY steht. Der Ausschuss setzt sich aus Vertretern der relevanten Ministerien/Abteilungen und Organisationen zusammen.

9.5 EC wird der PMA eine Empfehlung zur Genehmigung/Ablehnung/Änderung der Anträge geben. Auf der Grundlage der Empfehlungen von EC stellt PMA ein Genehmigungsschreiben an den Antragsteller aus, mit Kopie an MeitY.

9.6 MeitY wird Budgetvorkehrungen für die Auszahlung von Anreizen für genehmigte Projekte im Rahmen des Programms treffen. Die Auszahlung der Anreize erfolgt durch die PMA auf der Grundlage der Genehmigungsbedingungen und gemäß ihrer Finanzregeln. Die PMA wird MeitY den Finanzbedarf als konsolidierten Betrag regelmäßig und nicht auf Projektbasis vorlegen.

9.7 Der Erfolg des Systems werden von einem EZB-Rat (Governing Council) überprüft, der von MeitY unter dem Vorsitz von Sekretär MeitY gegründet wird. Der GC wird sich aus Experten der Regierung und der Industrie zusammensetzen. Der GC wird den Fortschritt des Systems und die Projekte regelmäßig überprüfen. Der GC ist befugt, von Zeit zu Zeit Änderungen an den Richtlinien des Systems vorzunehmen, um eine erfolgreiche Umsetzung des Systems zu gewährleisten. Die detaillierte Zusammensetzung, Funktionsweise und Verantwortlichkeiten des GC werden in den Richtlinien des Systems ausgearbeitet.

9.8 Die Liste der Güter, die für den Anreiz im Rahmen des Systems förderfähig sind, sowie die geltenden Schwellenwerte werden von Zeit zu Zeit vom EZB-Rat überprüft und geändert.

9.9 Für ein effektives Management des SPECS-Programms werden von MeitY eine Reihe von Beurteilungs- und Auszahlungsrichtlinien erstellt und zusätzlich herausgegeben.

9.10 Eine Halbzeitbewertung des Systems wird durchgeführt, um den Gewinn für die Industrie und die Wirtschaft im Hinblick auf die angegebenen Ziele zu bewerten.

**Liste der Waren, die für den Anreiz unter SPECS qualifizieren**

**A. Liste der Güter mit einer Mindestinvestitionsschwelle von INR 50 Millionen**

<b>S.Nr.</b>	<b>Beschreibung der Güter</b>
1.	SMT-Komponenten einschließlich LED-Chips
2.	Chipmodule für Chipkarten, RFID-Antenne und -Etiketten, CoB/ System in Package
3.	Passive Bauelemente wie Widerstände, Kondensatoren, Ferrite usw. für elektronische Anwendungen
4.	Elektromechanische Komponenten wie Transformatoren, Drosseln, Spulen, Relais, Schalter, Mikromotoren, Schrittmotoren, BLDC-Motoren, Steckverbinder, Kühlkörper, Antennen, Lautsprecher, Mikrofone usw. für elektronische Anwendungen
5.	Magnetrons, Wellenleiter, Zirkulatoren, Koppler, Isolatoren, Filter, Magnete, HF-Komponenten für elektronische Anwendungen
6.	Gedruckte Leiterplatten (PCBs), PCB-Laminare, Prepegs, Photopolymerfilme, PCB-Druckfarben; gedruckte flexible Elektronik
7.	Sensoren, Umformer, Stellmotoren und Kristalle für elektronische Anwendungen
8.	Kameramodule, Vibratormotor/ Rufton
9.	USB/Datenkabel, HDMI-Kabel
10.	Investitionsgüter für alle unter SPECS fallenden Güter

**B. Liste der Güter mit einer Mindestinvestitionsschwelle von INR 150 Millionen**

<b>S. Nr.</b>	<b>Beschreibung der Güter</b>
1	Aktive Komponenten: a. Diskrete Halbleiterbauelemente einschließlich Transistoren, Dioden usw. b. Leistungshalbleiter einschließlich FETs, MOSFETs, Thyristoren usw.
2	Vorform aus Kieselsäure und optischer Faser
3	Display-Baugruppe und Touch Panel/ Abdeckglas-Baugruppe

**C. Liste der Güter mit einer Mindestinvestitionsschwelle von INR 25 crore**

<b>S. Nr.</b>	<b>Beschreibung der Güter</b>
	Mikro-/Nanoelektronische Komponenten wie mikroelektromechanische Systeme (MEMS) und nanoelektromechanische Systeme (NEMS)
	Montage-, Prüf-, Markierungs- und Verpackungseinheiten (ATMP)

**D. Liste der Güter mit einer Mindestinvestitionsschwelle von INR 750 Millionen**

<b>S. Nr.</b>	<b>Beschreibung der Güter</b>
<b>1</b>	Mechanik (Kunststoff- und Metallteile) für elektronische Anwendungen

**E. Liste der Güter mit einer Mindestinvestitionsschwelle von INR 2,5 Milliarden**

<b>S. Nr.</b>	<b>Beschreibung der Güter</b>
<b>1.</b>	Verbindungshalbleiter wie GaN, SiC, GaAs usw. und Silizium-Photonik-Bauelemente/ Integrierte Schaltkreise, optoelektronische Komponenten

**F. Liste der Güter mit einer Mindestinvestitionsschwelle von INR 5 Milliarden**

<b>S. Nr.</b>	<b>Beschreibung der Güter</b>
<b>1.</b>	Halbleiter-Wafer

**G. Liste von Gütern mit einer Mindestinvestitionsschwelle von INR 10 Milliarden**

<b>S. Nr.</b>	<b>Beschreibung der Güter</b>
<b>1.</b>	Integrierte Halbleiterchips (ICs) einschließlich Logik [Mikroprozessor, Mikrocontroller, digitale Signalprozessoren (DSP), anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) usw.]; Speicher; Analog/Mischsignal-ICs usw.
<b>2.</b>	Einheiten zur Herstellung von Display, einschließlich Flüssigkristallanzeigen (LCD), Leuchtdioden (LED), organische Leuchtdioden (OLED) usw. für elektronische Anwendungen

\*\*\*\*